

The Global Production Engineering Company **Hirata**

世界の生産エンジニアリングメーカー

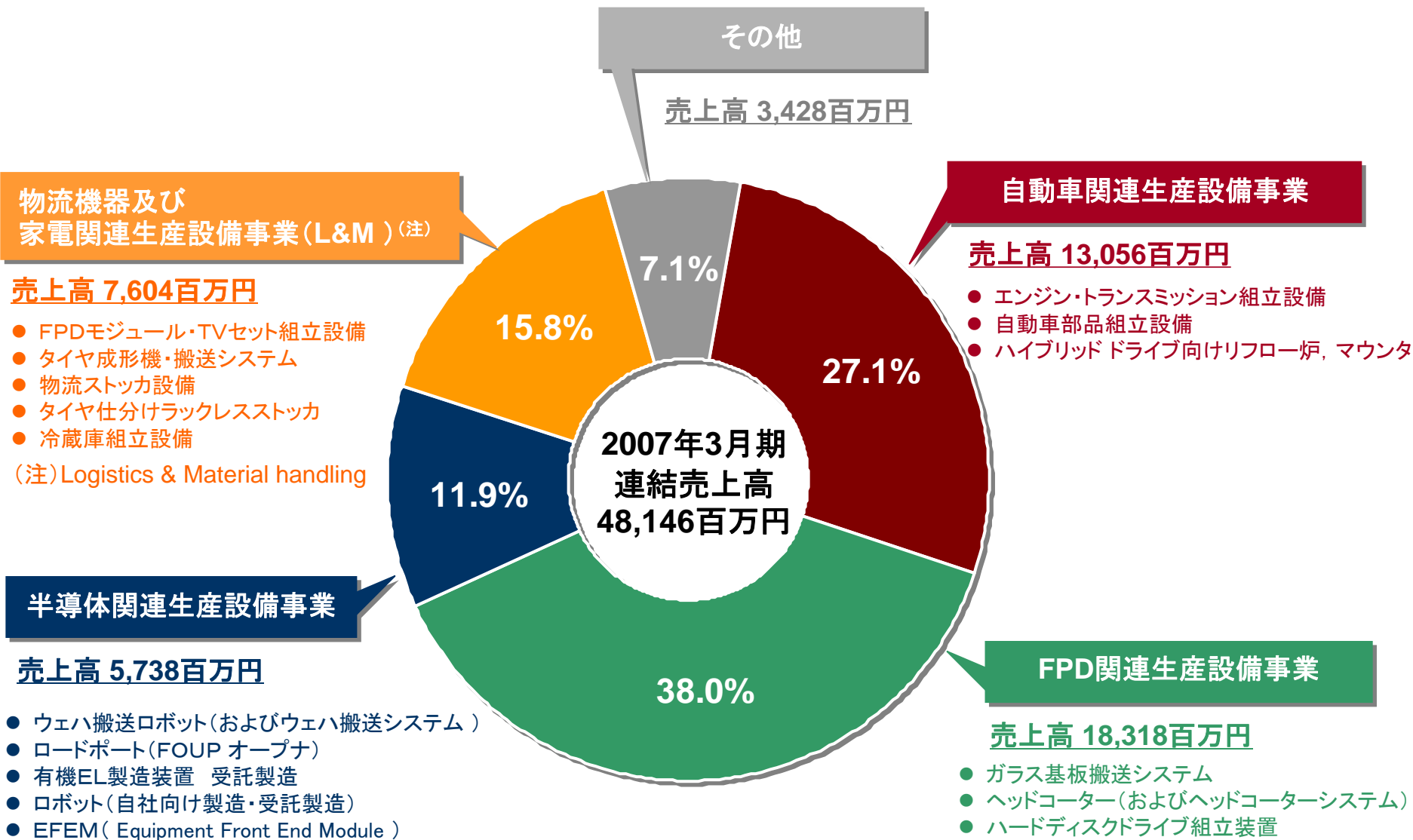


2007年3月期 決算説明会
(要約版)

2007年5月21日

平田機工株式会社

当社の事業概要



2006年3月期からの変更事項

<変更点>

組織の改編にともない事業部門の区分けを変更

自動車関連生産設備事業を担う組織の自動車ビジネスユニットに属していた「関西事業部」をFPD関連生産設備事業を担うFPDビジネスユニットに移管。

<変更理由>

関西事業部は、自動車関連生産設備やPDP等を含むFPD関連生産設備の製造、販売を行っていたが、2006年期中からFPD関連のウェイトが大きくなってきたため。

<2006年3月期事業部門別売上高比較>

(単位:百万円)

	06年3月期				増減
	変更前		変更後		
	金額	構成比	金額	構成比	
売上高	44,457	100.0%	44,457	100.0%	0
自動車	17,456	39.3%	13,419	30.2%	▲4,036
FPD	10,431	23.5%	14,467	32.5%	+4,036
半導体	5,022	11.3%	5,022	11.3%	0
L&M	8,519	19.2%	8,519	19.2%	0
その他	3,027	6.8%	3,027	6.8%	0

2007年3月期の業績について

P/L

- 2006年3月期、2007年3月期と2期連続で過去最高の売上高を達成
売上高：481億46百万円(前年同期比8.3%増) 営業利益：37億6百万円(同20.9%増)
経常利益：34億20百万円(同12.6%増) 当期純利益：18億69百万円(同46.3%増)

B/S

- 有利子負債の削減 (2006年3月期195億円→2007年3月期176億円)
- 自己資本比率の上昇 (2006年3月期24.8%→2007年3月35.8%)

C/F

- 財務C/F：株式発行による収入 30億40百万円

期末配当金

- 1株あたり22.5円(普通配当17.5円+創業60周年記念配当5円)を実施予定

2007年3月期 連結業績

(単位:百万円)

	2006/3期	2007/3期	増減	増減率	
売上高	44,457	48,146	+ 3,689	+ 8.3%	
営業利益	3,065 (6.9%)	3,706 (7.7%)	+ 641	+ 20.9%	
経常利益	3,038 (6.8%)	3,420 (7.1%)	+ 381	+ 12.6%	
税前利益	2,624 (5.9%)	3,104 (6.4%)	+ 479	+ 18.3%	
当期利益	1,278 (2.9%)	1,869 (3.9%)	+ 591	+ 46.3%	
研究開発費	311	921	+ 610	+ 196.3%	
設備投資額	596	967	+ 371	+ 62.2%	
減価償却費	555	588	+ 32	+ 5.8%	
対米ドル 為替レート	平均	110.20円	116.41円	+ 6.21円	+ 5.6%
	期末	118.07円	119.12円	+ 1.05円	+ 0.9%

計画を上回り増収増益

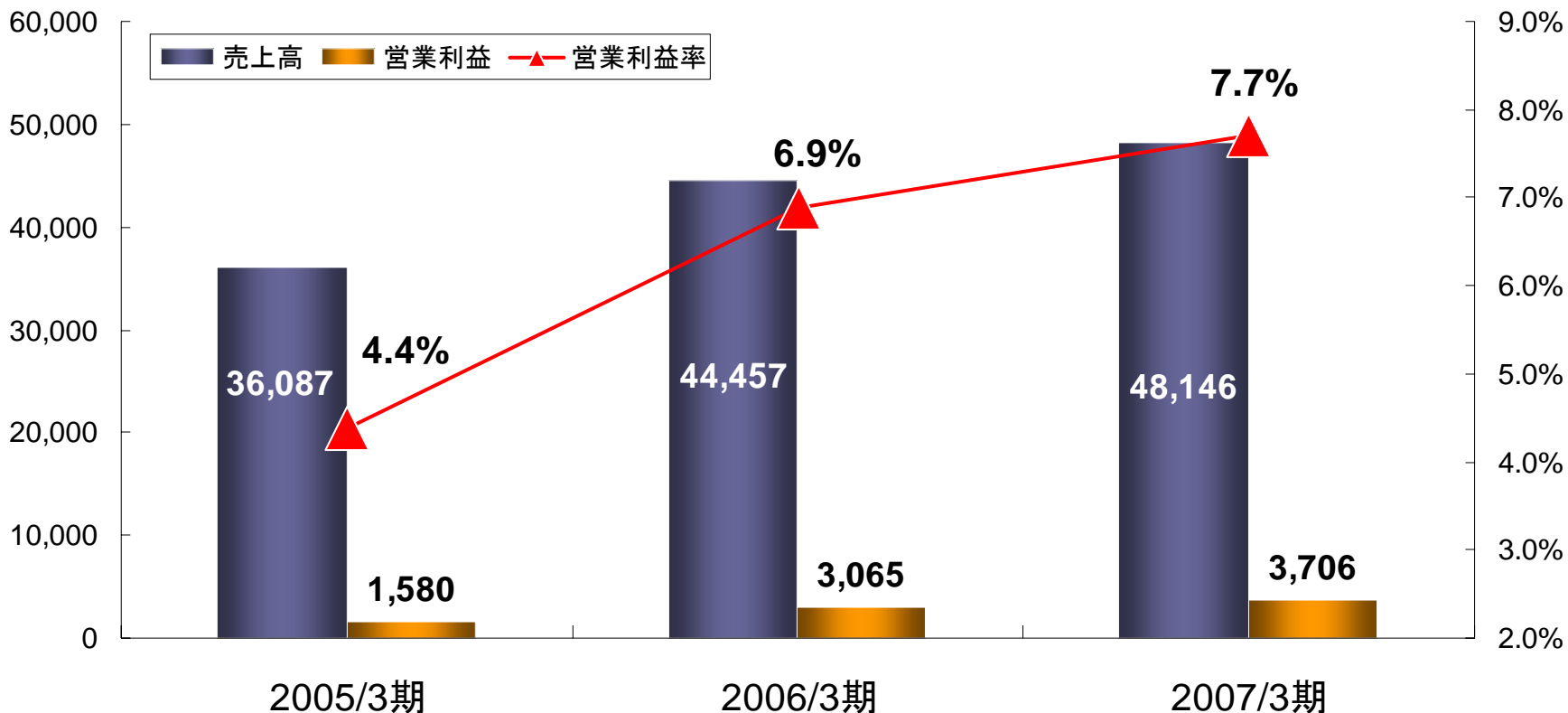
研究開発強化のための組織
変更に伴う要員増加

ユニット工場の新設、大型加
工機の導入

連結売上高・営業利益率推移

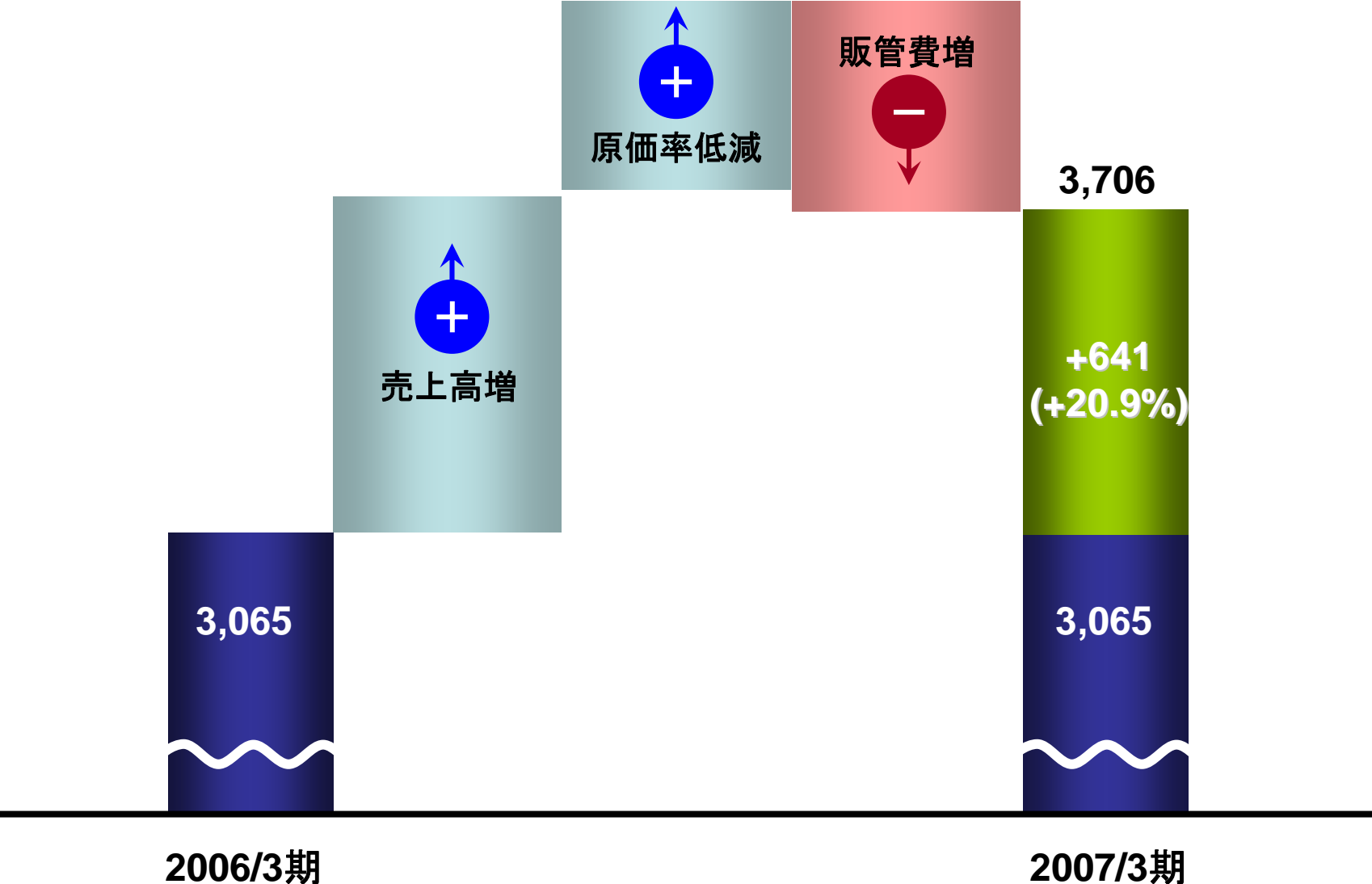
自動車産業における設備投資は、若干の変動はあるものの高水準で維持していることを下支えに、大画面薄型テレビの普及、また半導体分野の旺盛な設備投資により堅調な売上を維持。
2期連続で過去最高の売上高を達成。

(単位: 百万円)



営業利益の増減要因分析

(単位:百万円)



2007年3月期 事業部門別業績

(単位:百万円)

	2006/3期		2007/3期		増減	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
売上高	44,457	100.0%	48,146	100.0%	+ 3,689	+ 8.3%
自動車	13,419	30.2%	13,056	27.1%	▲ 363	▲ 2.7%
FPD	14,467	32.5%	18,318	38.0%	+ 3,851	+ 26.6%
半導体	5,022	11.3%	5,738	11.9%	+ 716	+ 14.3%
L&M	8,519	19.2%	7,604	15.8%	▲ 915	▲ 10.7%
その他	3,027	6.8%	3,428	7.1%	+ 401	+ 13.2%

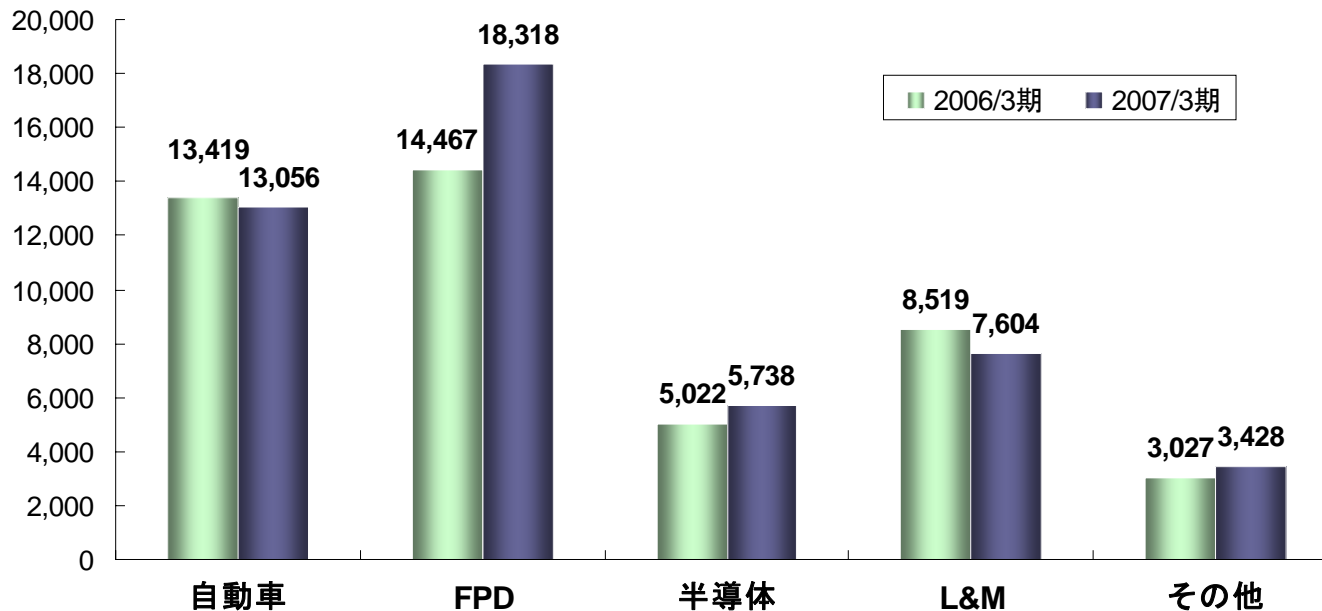
北米の自動車メーカー向け売上低下

国内の旺盛な投資による売上高増

国内のデジタル家電の需要拡大によるメモリーメーカーの設備投資が堅調に推移したことによる売上高増

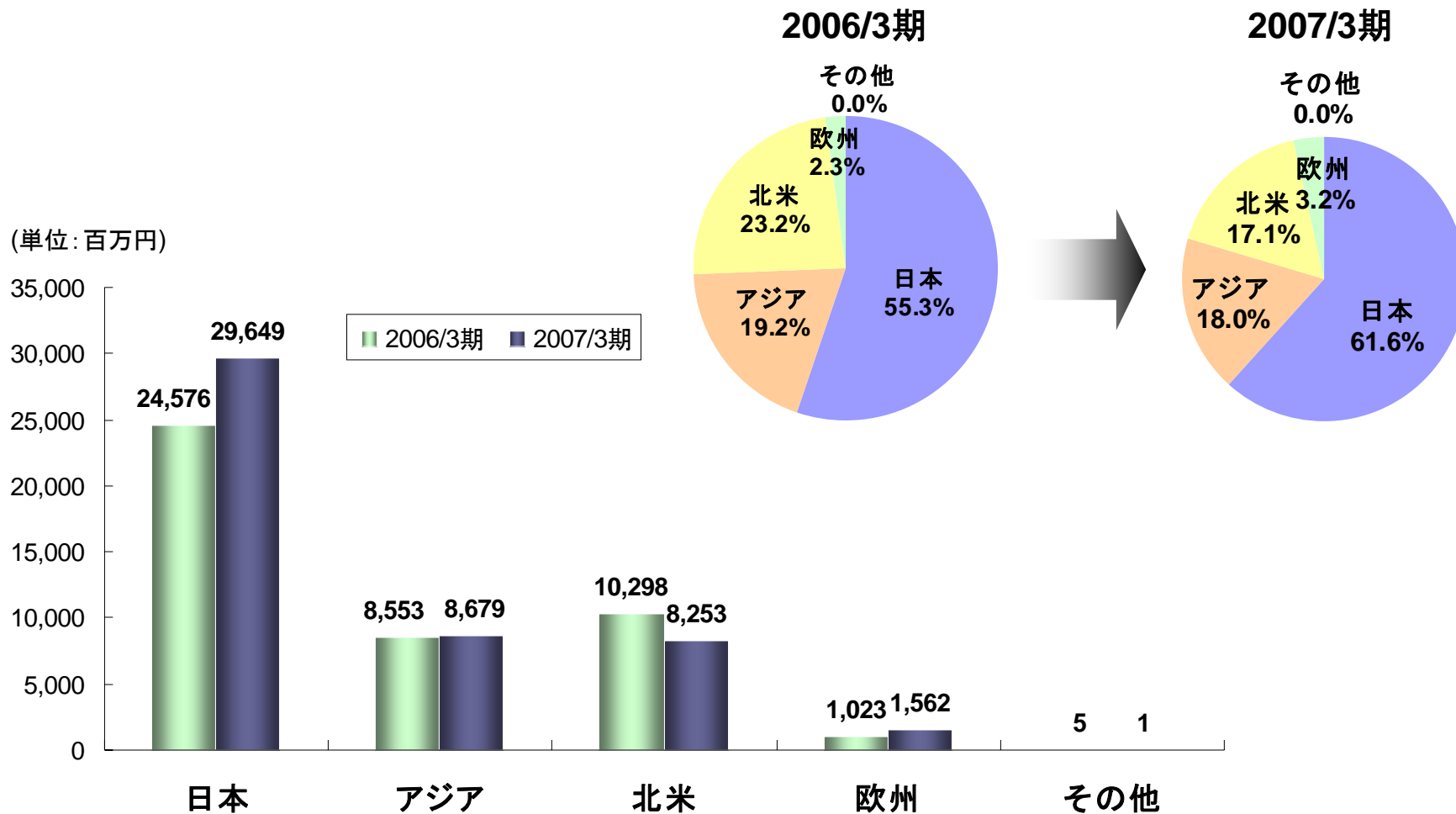
北米および東南アジアにおける家電市場の設備投資が堅調に推移、一方でタイヤ業界向けの売上が低調だったことによる売上高減

(単位:百万円)



地域別売上高の状況

前期と比較して、日本の比率が6.3ポイント増加。同時に北米が6.1ポイント減少。



連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2006/3期	2007/3期	増減	増減率
流動資産	40,310	35,391	▲4,919	▲12.2%
現金及び預金	5,845	5,453	▲392	▲6.7%
受取手形・売掛金	21,557	19,571	▲1,985	▲9.2%
たな卸資産	10,671	8,722	▲1,949	▲18.3%
固定資産	19,103	18,949	▲153	▲0.8%
有形固定資産	14,714	14,979	+265	+1.8%
無形固定資産	159	148	▲10	▲6.7%
投資その他の資産	4,229	3,821	▲408	▲9.7%
資産合計	59,413	54,341	▲5,072	▲8.5%
流動負債	32,396	23,601	▲8,795	▲27.1%
支払手形・買掛金	12,310	7,242	▲5,067	▲41.2%
固定負債	12,161	11,155	▲1,006	▲8.3%
負債合計	44,558	34,756	▲9,801	▲22.0%
資本金	1,099	2,633	+1,534	+139.6%
資本剰余金	685	2,322	+1,637	+238.8%
利益剰余金	8,006	9,703	+1,696	+21.2%
自己株式	▲151	0	+150	▲99.4%
純資産合計	14,746	19,584	+4,837	+32.8%
負債及び純資産合計	59,413	54,341	▲5,072	▲8.5%
総資産回転率	0.75回	0.89回	+0.14回	+18.4%

受取手形・売掛金の減少

たな卸資産減少

支払手形・買掛金の減少

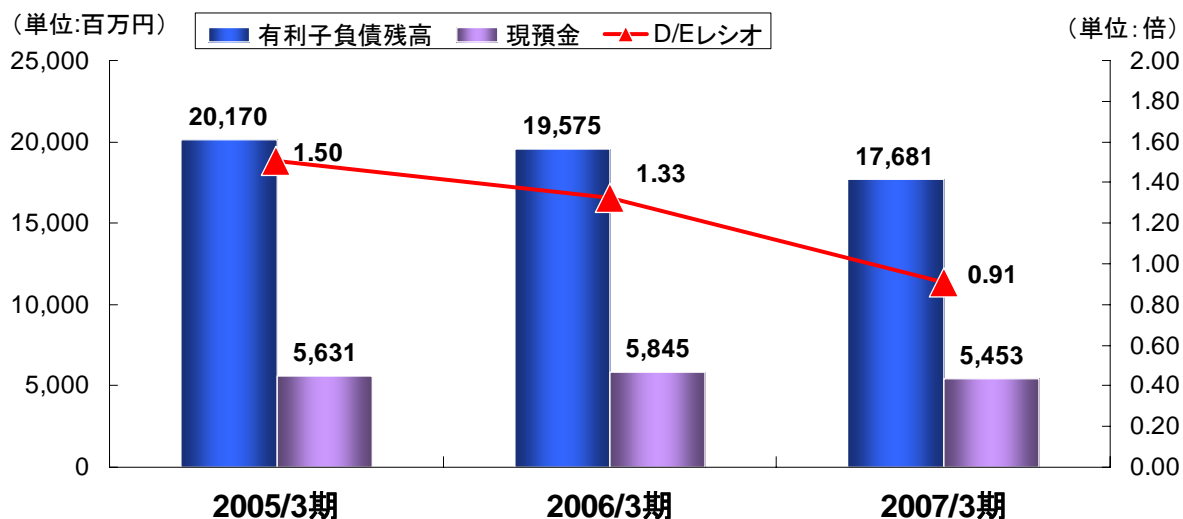
有利子負債を削減

JASDAQ上場に伴う公募増資等による増加

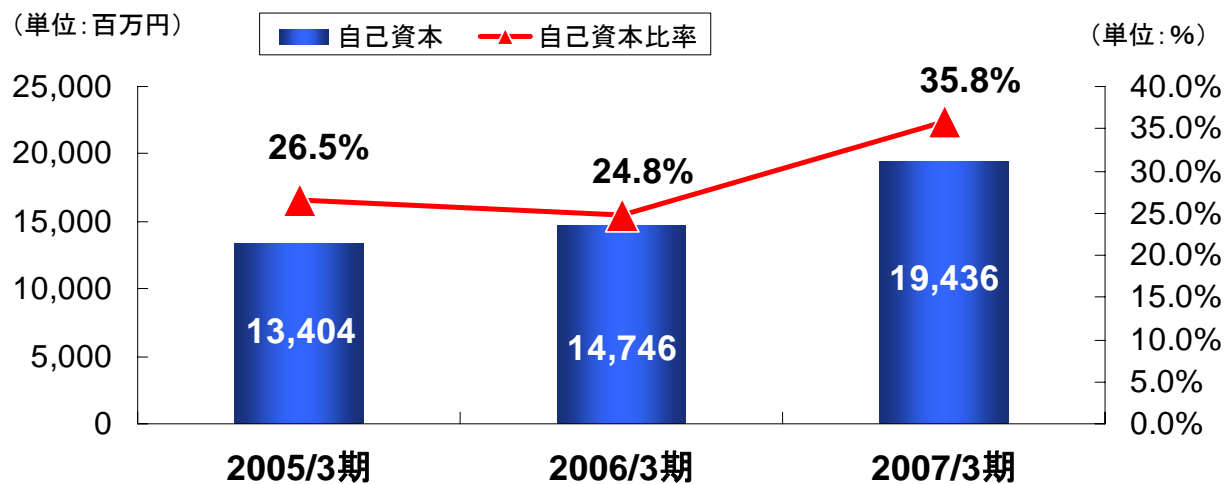
将来の投資に備えて内部留保
 <投資対象>
 ・コスト競争力の向上
 ・技術・製造開発体制強化
 ・グローバル戦略の展開

有利子負債残高・自己資本比率の推移

有利子負債残高・D/Eレシオ

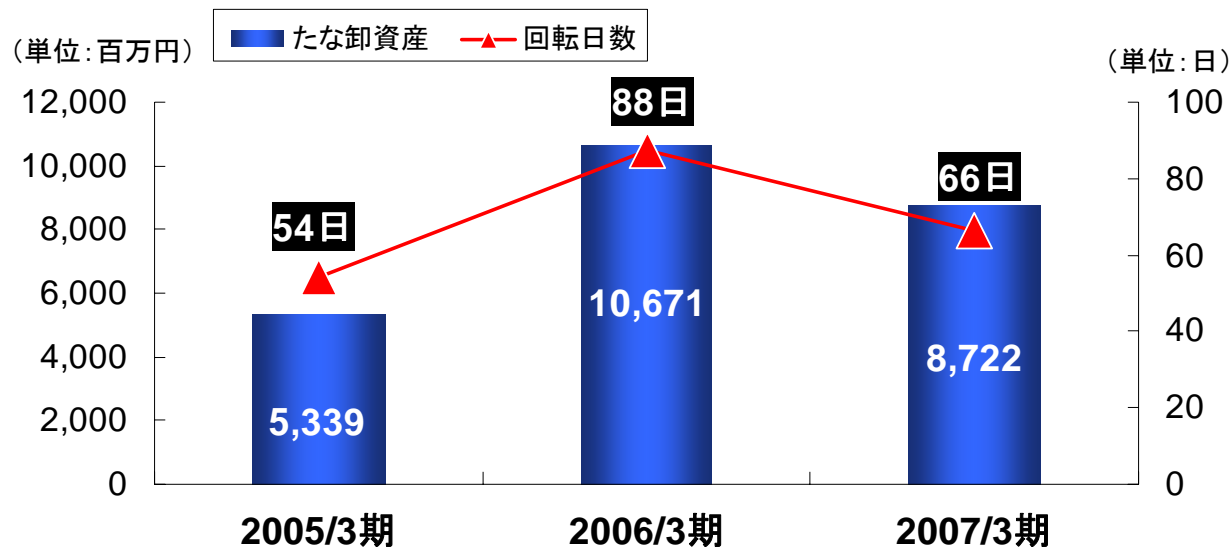


自己資本比率

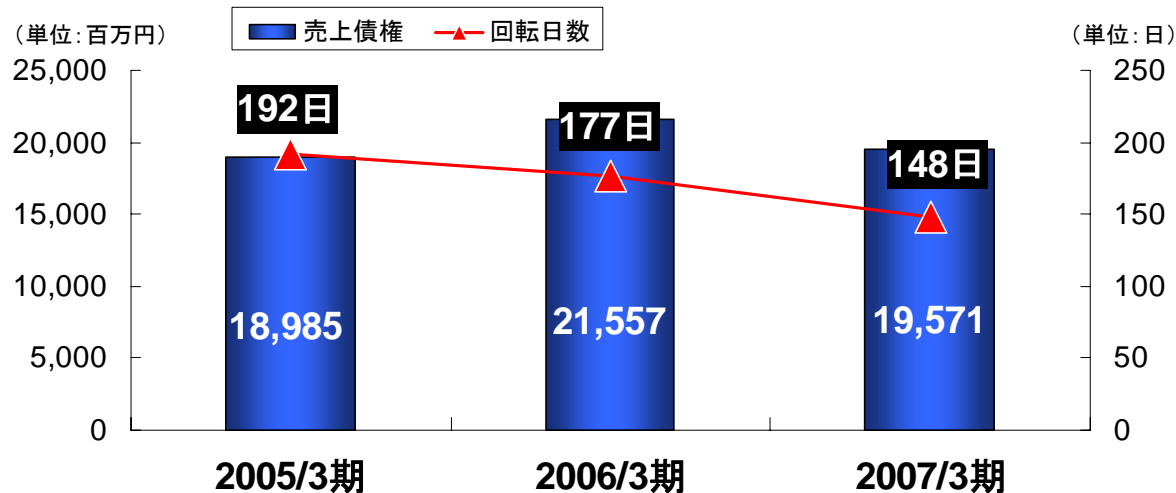


たな卸資産・売上債権の回転日数の推移

たな卸資産



売上債権



連結キャッシュフロー

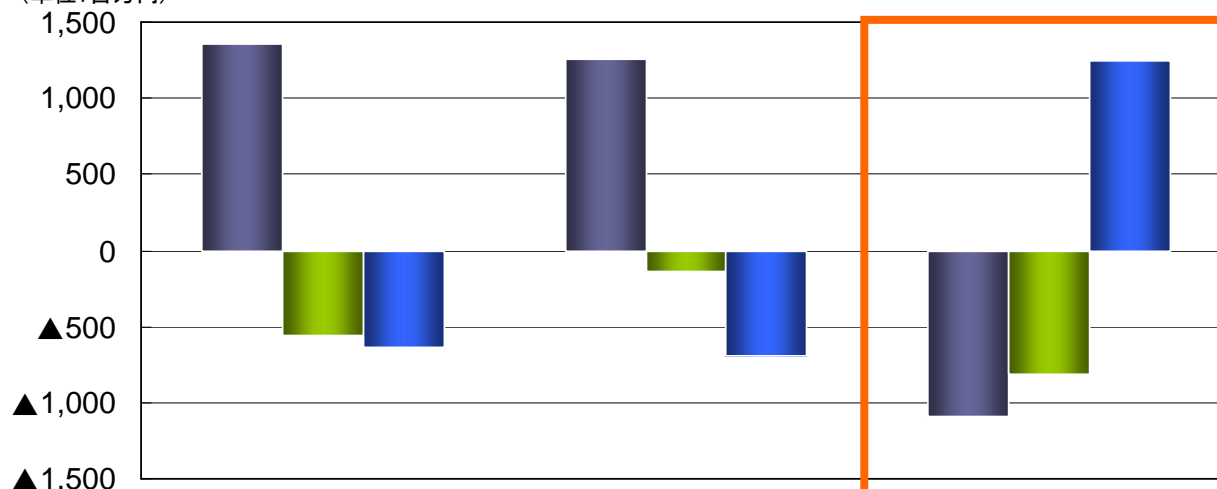
現金及び現金同等物残高は5,220百万円(前期比624百万円減少)

営業C/F：税金等調整前当期純利益31億4百万円に対し、前受金の減少、法人税等の支払額増加により、10億92百万円の支出

投資C/F：有形固定資産の取得等により、8億15百万円の支出

財務C/F：株式の発行による収入、短期借入金の減少等により、12億45百万円の収入

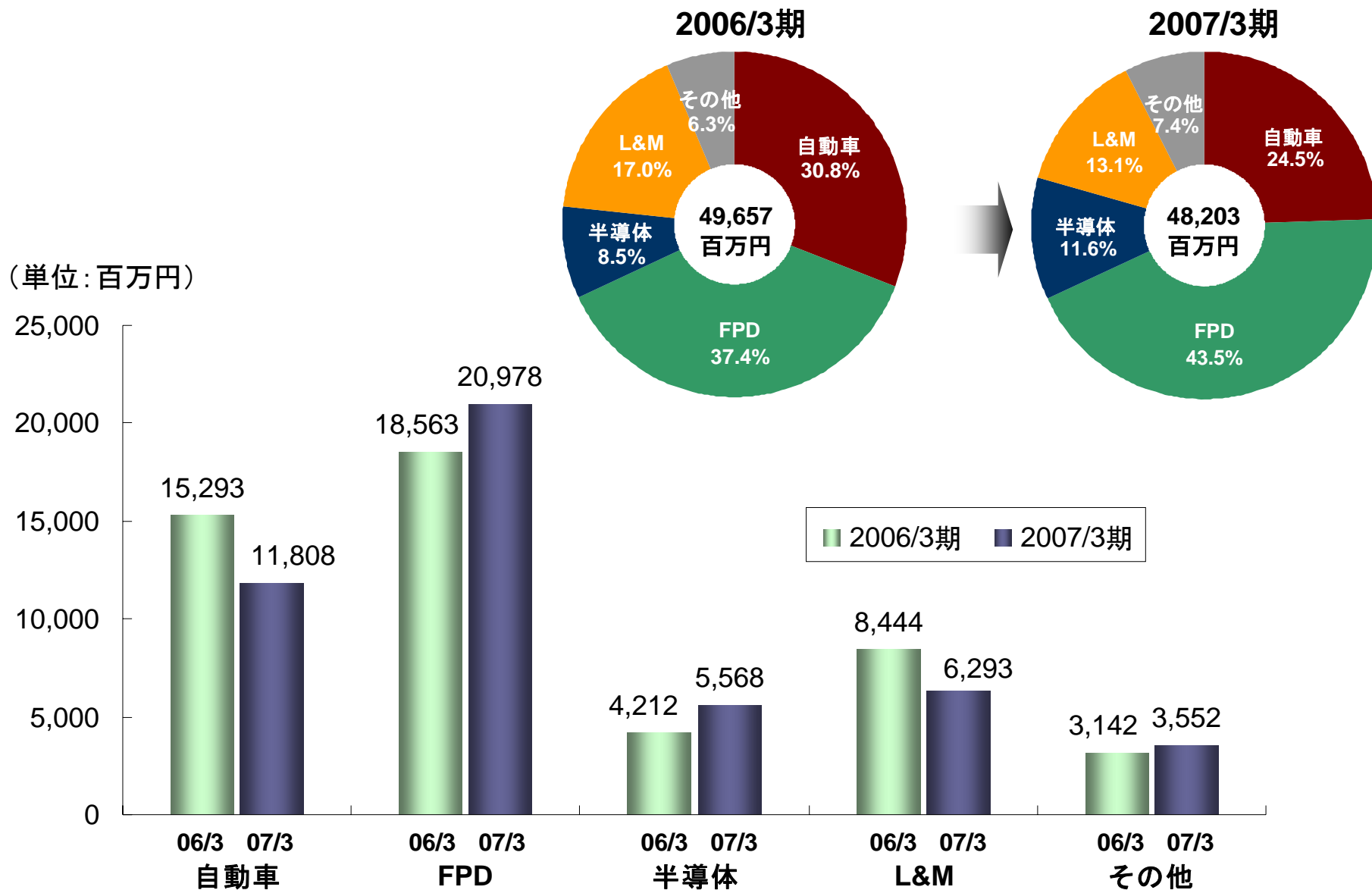
(単位:百万円)



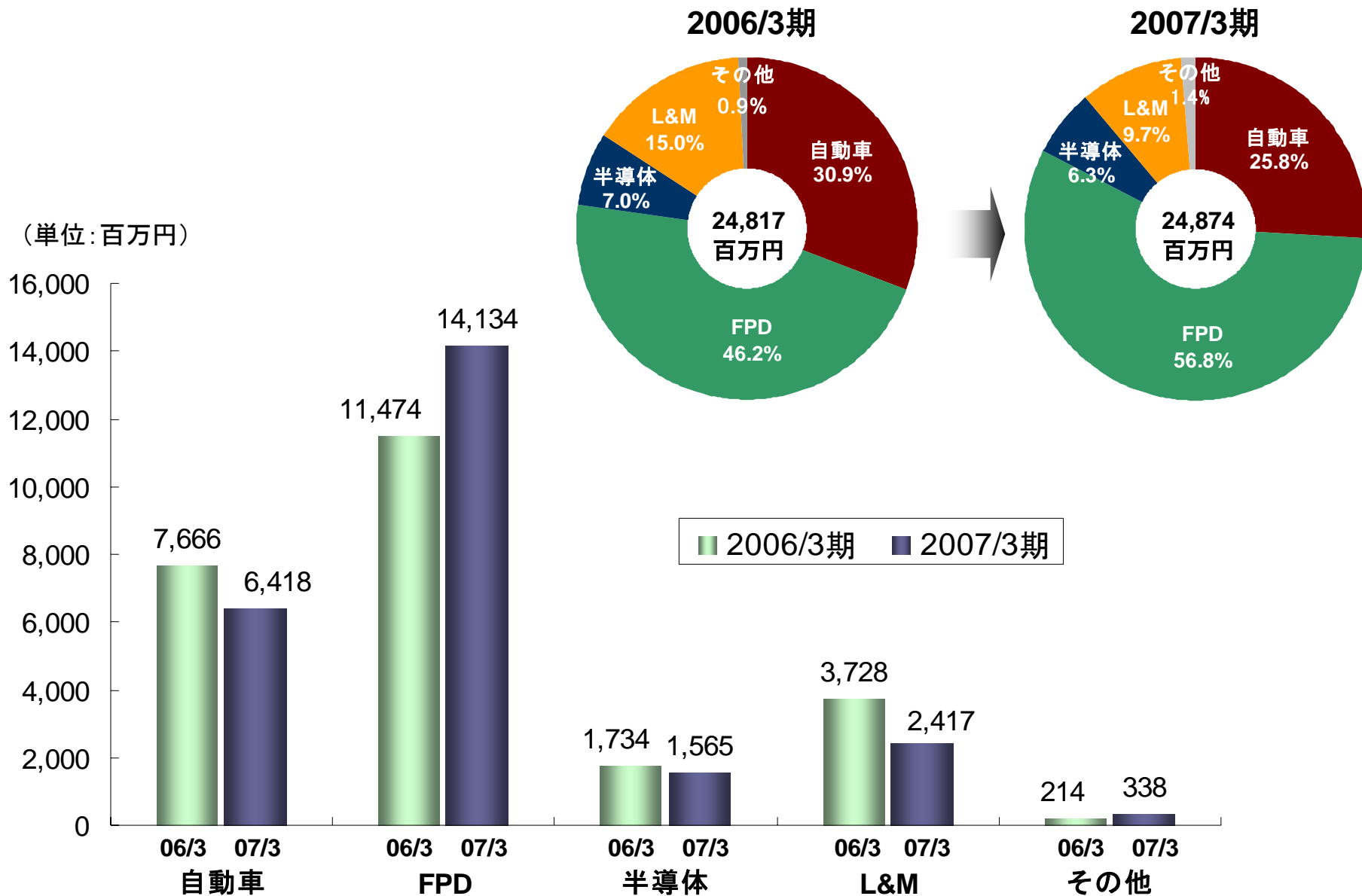
(単位:百万円)

	2005/3期	2006/3期	2007/3期
■ 営業C/F	1,355	1,253	▲1,092
■ 投資C/F	▲564	▲133	▲815
■ 財務C/F	▲636	▲695	1,245
現金等期末残高	5,351	5,845	5,220

受注高の状況



受注残高の状況



業績見通しについて

2007年度(2008/3期)連結業績見通しのポイント

4期連続の増収増益で、持続的成長と収益の安定化。

単位: 百万円・%

	2004年度	2005年度	増減額 (対前期)	増減率 (対前期)	2006年度	増減額 (対前期)	増減率 (対前期)	2007年度 (見通し)	増減額 (対前期)	増減率 (対前期)
売上高	36,087	44,457	+8,369	+23.2%	48,146	+3,689	+8.3%	50,000	+1,853	+3.8%
営業利益	1,580	3,065	+1,484	+93.9%	3,706	+641	+20.9%	3,800	+94	+2.5%
経常利益	1,382	3,038	+1,656	+119.8%	3,420	+381	+12.6%	3,600	+179	+5.2%
当期純利益	706	1,278	+572	+80.9%	1,869	+591	+46.3%	2,000	+130	+7.0%

持続的成長と 収益の安定化

- ✓ **グローバルな事業活動の強化**
 - ・ マーケティングカ・グループ各社の協力関係強化
 - ・ 海外事業本部を設置し、統括的な管理体制による効率的経営資源の投入
- ✓ **収益力強化**
 - ・ 生産情報のスピード化による合理的・効率的な生産活動による原価低減

技術力の強化

- ✓ **生産システム提案の基礎技術であるロボット技術等の抜本的強化**
 - ・ 基礎技術部を新設し、技術者の集約と開発の効率化

顧客満足向上

- ✓ **サービス機能強化**
 - ・ 市場の変化を捉え、顧客の声を敏感に捉え対応すべく、平成19年2月に子会社ヒラタ工営をヒラタフィールドサービス㈱へ商号変更および業容変更（平成19年4月より営業開始）

コンプライアンスの徹底

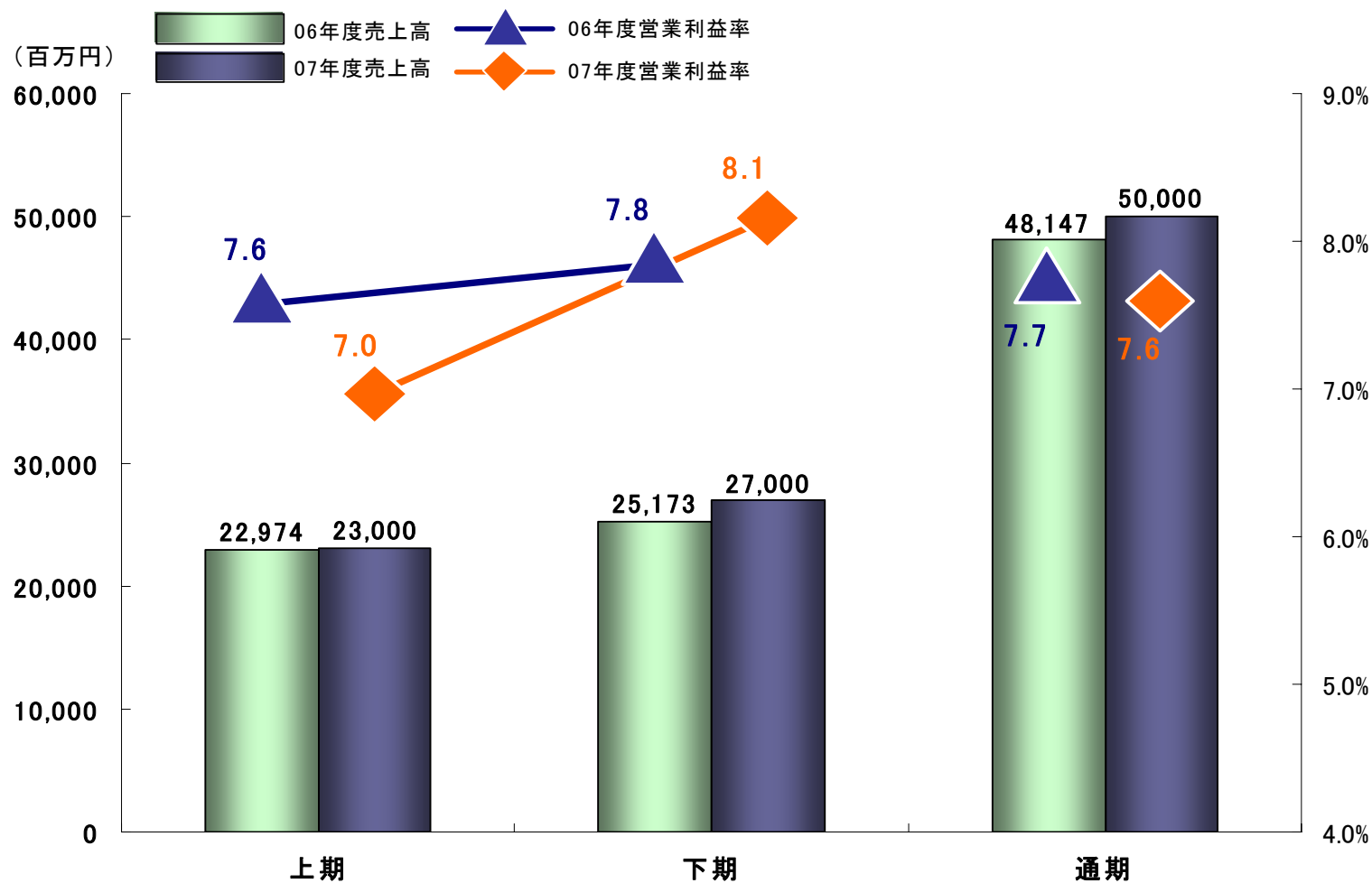
- ✓ **法令ならびに業務管理に関する社内規程の決裁手続きの遵守、機密管理の整備等を一層強化すべく法務機能を充実（平成17年9月に「コンプライアンス憲章」を策定）**

株主さまへの 利益還元

- ✓ **安定した配当を継続**
 - ・ 2008年3月期の期末配当は17.5円を予想
(2007年3月期:1株あたり普通配当17.5円に創業60周年記念配当5円を加え、22.5円の配当を予定)

2007年度(2008/3期)連結売上高・営業利益率見通し

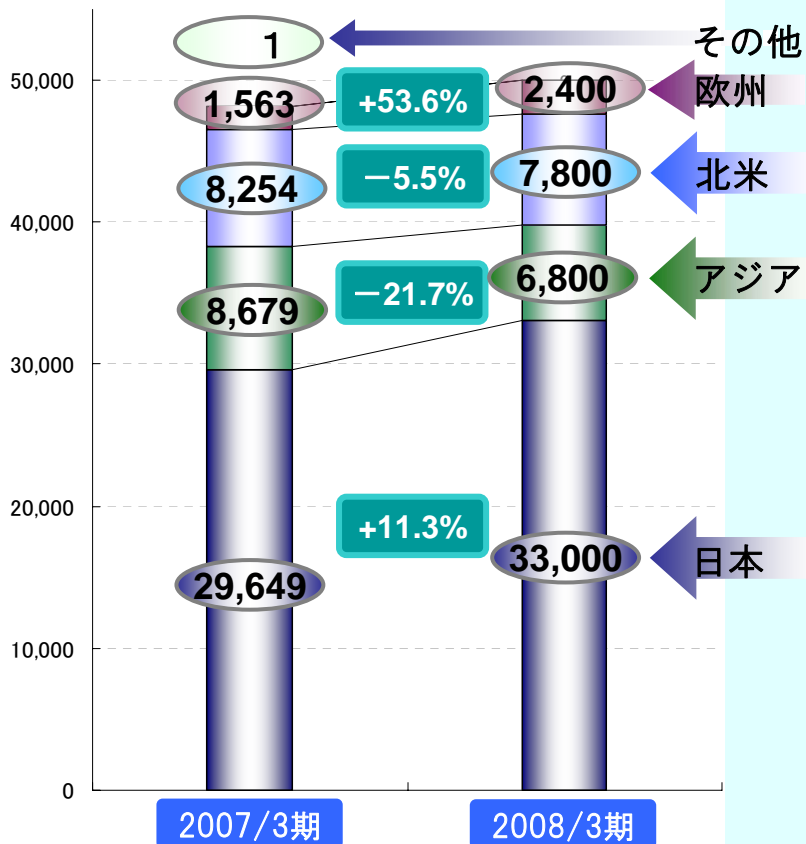
■ 下期 営業利益は8.1%、通期 7.6%



2007年度(2008/3期)地域別売上高・事業部門別売上高見通し(06Y→07Y(見通し))

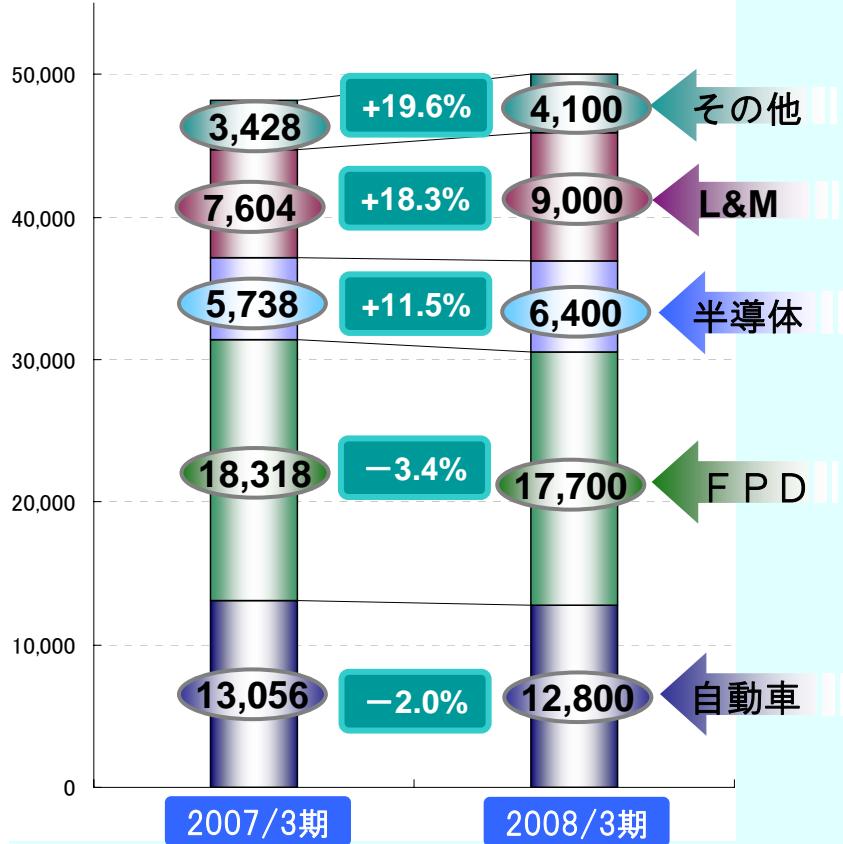
地域別売上高

2007/3期	2008/3期
48,146百万円	50,000百万円



事業部門別売上高

2007/3期	2008/3期
48,146百万円	50,000百万円



自動車分野

- ▶ エンジン・トランスミッション組立設備
 - ✓ ベースマシンの組み合わせによるフレキシブルなパワートレイン生産システムの売上拡大
- ▶ 自動車部品組立設備
 - ✓ 高成長の車載用部品(安全・省エネ・環境)向け設備の拡販
- 地域
 - ✓ 国内は微増、北米市場は横ばい、中国市場へ拡販



FPD分野

- ▶ FPDガラス基盤搬送ロボット
 - ✓ 第10世代ガラス基板用搬送用ロボットの市場投入
- ▶ レジスト塗布装置
 - ✓ 東京エレクトロンとの協業強化(大型基板サイズ用ヘッドコート)
- 地域
 - ✓ 台湾の減少、国内は横ばい
 - ✓ 台湾拠点は次期投資を見据えたマーケティング・サービス開始



第10世代
ガラス基板搬送ロボット
(07.5.14発表)



半導体分野

- ▶ ウェハ搬送ロボット
- ▶ ロートポート
- ▶ EFEM(Equipment Front End Module)
✓上位シェア製造装置メーカーへの安定的採用

- 地域
✓装置需要は各地域とも前期並み

L&M分野

- ▶ 家電関連組立搬送設備
✓FPDモジュール工程・薄型TV組立工程設備の拡販
✓半導体後工程搬送装置の安定受注

- ▶ タイヤ関連搬送設備
✓受注範囲拡大による増収効果

- 地域
✓薄型TVは、欧州・北米(中米)で投資旺盛
✓ワールドワイドのネットワークで、成長機会を最大化

中期経営計画について

－ 目次 －

1. 概要

1) 理念と方向性

2. 中期経営計画(1・2・3・4計画)について

1) 業容・収益の持続的成長

2) 財務構造の改善

3) 主な取り組みの進捗状況

4) 事業戦略

1. 概要

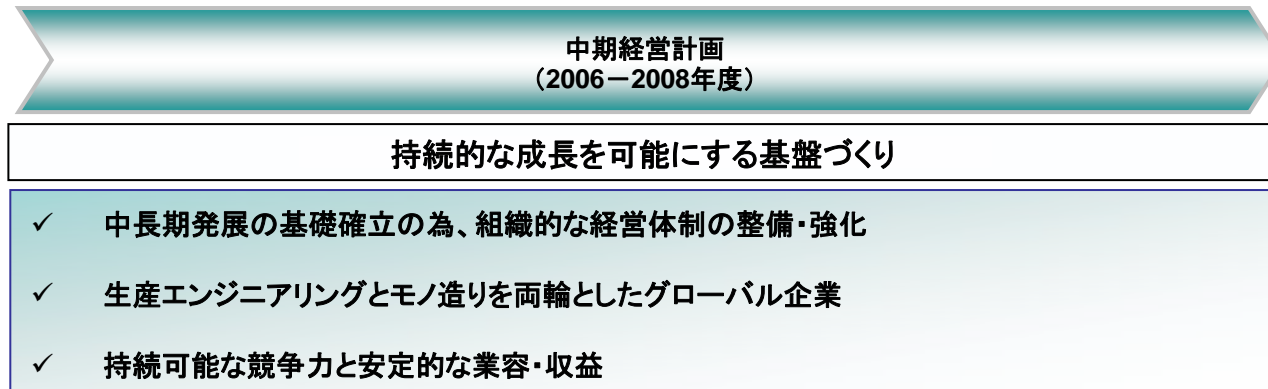
1) 理念と方向性

当社は、中期経営計画を2006年に策定しました。
このたび、現時点での計画の達成状況について公表すると共に当中期計画の概要について、
以下ご説明いたします。

2006年は、創業60周年、設立55周年という記念すべき年でもあり、また上場の準備を進めてきたことから、「中長期的な発展の基礎を確立」することを狙いとした中期経営計画を策定いたしました。
当社は、人間尊重を貫き、技術革新に努め、顧客の利益を優先し、本業を通じて社会に貢献する企業を目指しています。

今後もこうした理念を大切にしながら、「自動車・FPD・半導体分野における生産エンジニアリングのリーディングカンパニー」を目指しております。

■ 中期経営計画の位置づけ



次期中期経営計画

09Y 10Y 11Y

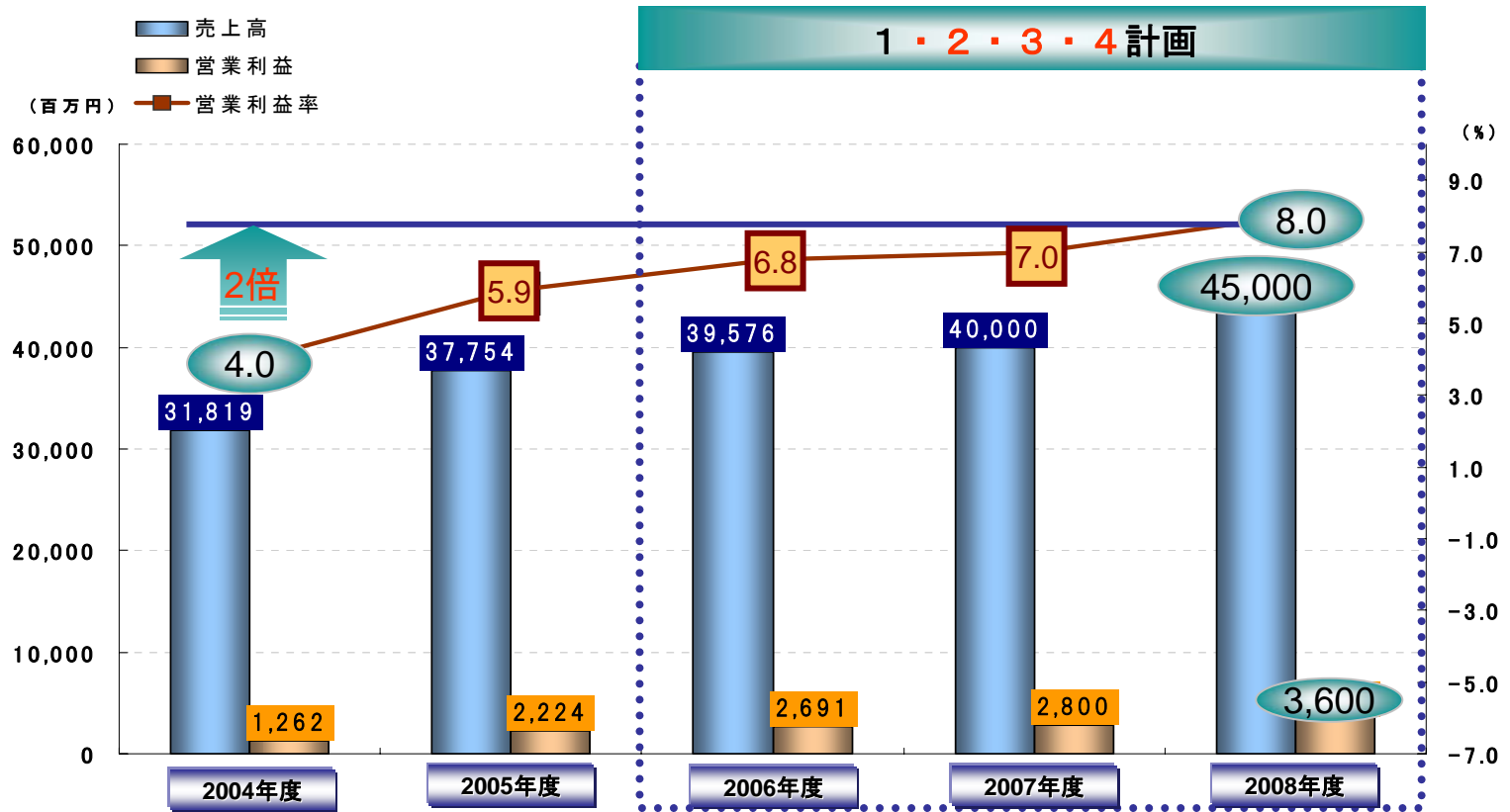
新フェーズ

強固な経営基盤を
礎として事業の拡大
による成長へ！！

中期経営計画(平田機工個別) 2007年度(2008/3期)から2008年度(2009/3期)

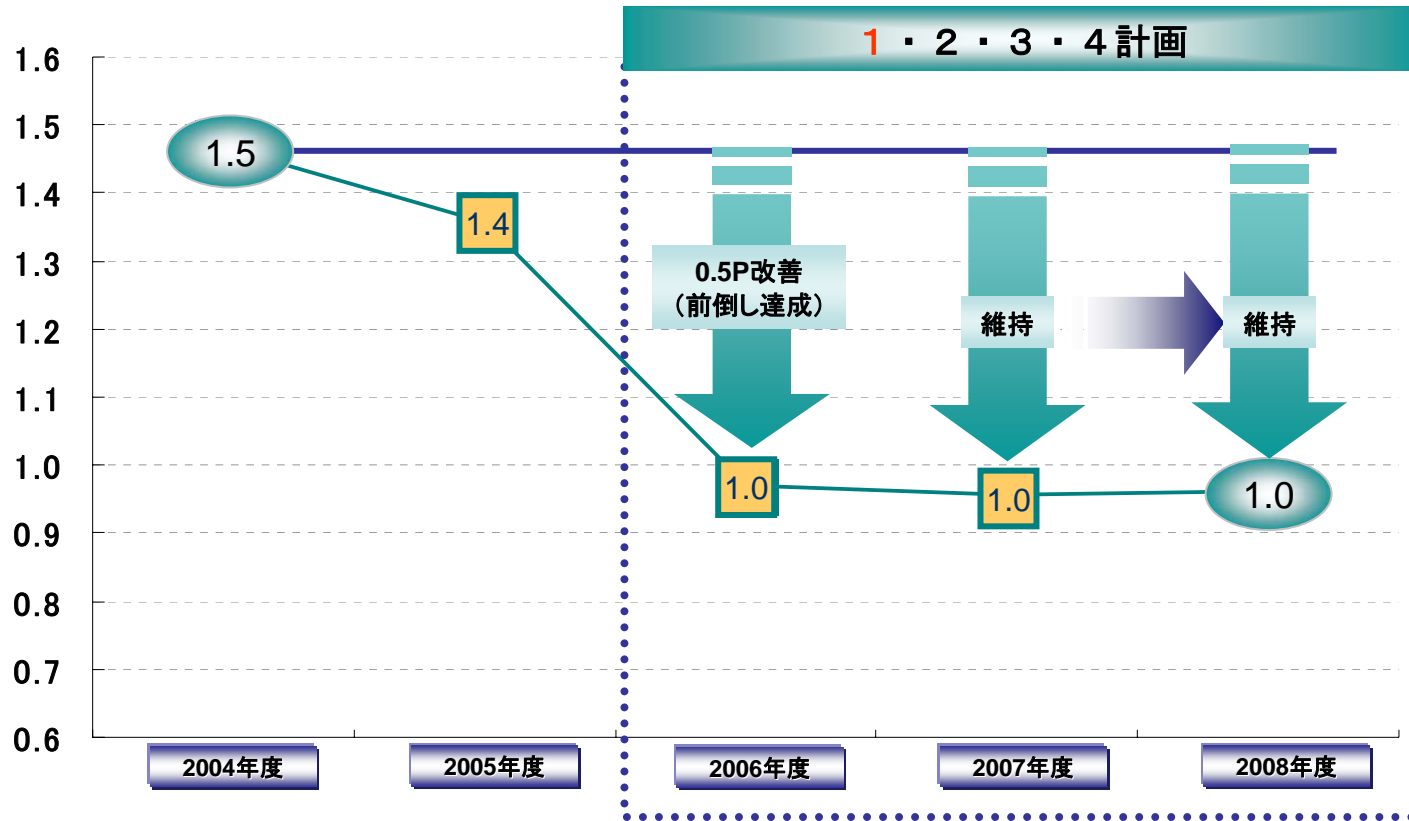
2. 中期経営計画(1・2・3・4計画)について

1) 業容・収益の持続的成長



経営指標	1	負債比率 1以下	2	営業利益率 2倍以上 (2005年3月期比)	4	売上高 450億円以上
	ドライバー					
3			リードタイム30%短縮			

2) 財務構造の改善



経営指標	1	負債比率 1以下
	2	営業利益率 2倍以上 <small>(2005年3月期比)</small>
ドライバー	3	リードタイム30%短縮
	4	売上高 450億円以上

3) 主な取り組みの進捗状況

目指す姿	テーマ	取り組み
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">自動車・FPD・半導体分野における 生産エンジニアリングのリーディングカンパニー</p>	<p>中長期発展の基礎確立の為、 組織的な経営体制の整備・強化</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 事業体制の整備 <ul style="list-style-type: none"> ✓ビジネスユニットの設置(事業部門再編成) ■ 管理体制の整備 <ul style="list-style-type: none"> ✓コンプライアンス憲章制定 ✓法務室を設置
	<p>生産エンジニアリングとモノ造りを両輪とする グローバル企業</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ マーケティング強化 <ul style="list-style-type: none"> ✓海外事業本部を設置 ✓台湾平田を設立(07Y本格的稼働) ✓ヒラタフィールドエンジニアリングの営業開始 ■ モノ造り力強化 <ul style="list-style-type: none"> ✓中国新会社設立(工場建設中) ✓大型工作機械(五面加工機)導入 ・熊本、宇都宮に配備
	<p>持続可能な競争力と 安定的な業容・収益</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 収益体質改善 <ul style="list-style-type: none"> ✓LT307プロジェクト ✓迅速な生産体制の整備 ✓個別採算管理の徹底 ■ 技術の抜本的強化 <ul style="list-style-type: none"> ✓基礎技術部を設置

4) 事業戦略

自動車分野

■ エンジン・トランスミッション組立設備

- ✓国内で圧倒的No. 1を維持しながら、北米でのシェアアップ
- ✓新興市場向け(新コンセプト)システムの開発、販売

■ 自動車部品組立設備

- ✓高成長の車載用部品(安全・省エネ・環境)をターゲットに製品開発
- ✓国内メインプレイヤーへの販売体制強化

FPD分野

■ 基板搬送システム

- ✓大型搬送モジュールのインテグレーションシステムの拡販強化
- ✓G10を見据えたロボット開発
- ✓台湾市場の販売・サービス体制を強化
- ✓中国市場の販売・生産体制構築

■ レジスト塗布装置

- ✓東京エレクトロとの協業関係強化

半導体分野

■ ウェハ搬送ロボット/ロードポート/EFEM

- ✓半導体装置メーカー上位への拡販強化
- ✓北米市場の販売体制強化

■ 直交型ロボット

- ✓自動車部品向け組立セル用直交型ロボット
- ✓フラットテレビ専用直交型ロボット

L&M分野

■ 家電関連設備

- ✓世界的なFPD TV需要拡大を睨んだ製造・販売体制の強化
 - 中米、東欧への販売強化
 - 現地製造・販売・サポート強化

■ タイヤ関連設備

- ✓メインプレーヤーへの製造・販売体制の強化
 - 基幹製品の拡販
 - 周辺機器及び、製品ラインナップ拡充による事業規模の拡大

生産体制

■ 500億円規模のビジネス規模に対応した生産体制の整備

- ✓生産効率・品質向上を目的としたユニット工場を建設
- ✓製品の大型化による調達スピード、コスト上昇を吸収すべく、大型工作機械(五面加工機)を新たに導入
- ✓中国市場に対応すべく上海に新工場建設

■ 製品製作リードタイムおよび、品質確保の徹底

- ✓3D CADの追加導入により、製品構想から設計、製造までのリードタイム短縮

開発体制

■ プロダクトアウト型の商品開発

- ✓応用技術の進化による、要素デバイス企画・開発強化

■ ロボット技術強化

- ✓要素技術開発の深堀思考によるコア技術強化
 - 基本性能強化(高速化・高精度化)、ビジョン機能、通信

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることがあることをご承知おきください。